

参加者募集

第5回 セラミックスエンジニアリングワークショップ 『エンジニアリングセラミックスのプロセスと物性制御』

主催： 日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会
 共催： 次世代バルクセラミックス基盤技術研究会
 日時： 2014年11月7日（金）13：00～8日（土）12：00（予定）
 場所： ハイパーリゾート ヴィラ塩江
 （住所：香川県高松市塩江町上西乙 688-1, 電話番号：087-893-1111）
 WEB: http://www.hyper-inn.net/asp/nwsitem.asp?nw_id=114

プログラム（予定）：

11月7日（金）13：00～17：30

- 「粒界を利用したセラミックスの電気抵抗制御」○楠瀬尚史（香川大学）
- 「ファイラー充填を制御した放熱シートの高熱伝導化」○林 裕之・林 蓮貞（株）KRI
- 「透明蛍光サイアロンバルク体の作製」○多々見純一・佐野由紀・田中健大・飯島志行（横浜国立大学）、高橋拓実（神奈川科学技術アカデミー）、横内正洋（神奈川県産業技術センター）
- 「機械的手法によるリチウムイオン電池用正極粉体の直接合成」○小澤隆弘・中村衣利・松岡光昭・近藤 光・内藤牧男（大阪大学）
- 「エアロゾルデポジション法による耐プラズマ性部材の開発」○清原正勝（TOTO（株））
- 「Thermal Properties and Fabrication of ZrO₂ Based Composites for Thermal Barrier Coatings Application」○張 炳國（（独）物質・材料研究機構）
- 「粘性焼結におけるガラス粒の収縮挙動予測のための焼結力の有限要素解析」○桂 浩太・篠田 豊・赤津 隆・若井史博（東京工業大学）
- 「水熱ホットプレスによる多孔体の作製と物性評価」○柳澤和道（高知大学）

20：30～

討論会「エンジニアリングセラミックスのこれから」

11月8日（土）9：30～12：00

- 「粘性体に基づくセラミックス積層材の焼結過程での応力評価モデル」○安田公一（東京工業大学）、中山忠親・田中 諭（長岡技術科学大学）
- 「配向成形体の焼結時の配向構造発達挙動」○田中 諭（長岡技術科学大学）
- 「配向制御した炭化ケイ素における特性の方位依存性」○鈴木 達・西村聡之・打越哲郎・目 義雄（（独）物質・材料研究機構）
- 「電気泳動堆積法により形成した粒子堆積膜の乾燥割れを防ぐ2, 3のアイデア」○打越哲郎・鈴木 達（（独）物質・材料研究機構）

参加費：一般 15,000円（1泊2食付き，参加登録費 5,000円，宿泊費 10,000円）

学生 11,000円（1泊2食付き，参加登録費 1,000円，宿泊費 10,000円）

定員：30名（定員になり次第，締め切ります．お早めにお申し込み下さい）

参加申込：(1) 10月28日（火）までに，e-mailで参加申込みの旨を下記までご連絡下さい．折り返し，参加申込を受け付けたことの返信をお送り致します．

楠瀬尚史（香川大学）

e-mail: kusunol5@eng.kagawa-u.ac.jp, TEL/FAX: 087-864-2401

(2) 10月29日（水）までに，下記の銀行口座に，参加費をご送金ください．銀行振込の振込受領書を領収書に変えさせていただきます．

三菱東京UFJ銀行 千里中央支店（普）0073211

日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

問い合わせ先：上記の e-mail（あるいは TEL/FAX）で楠瀬までお問い合わせ下さい．詳細は，日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会ホームページなどでもお知らせする予定です．

URL: http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html